

技术参数

5701

日期:10/2014

www.stick1mat.com



上海禧合应用材料有限公司

产品介绍

5701 是一款单组分快速固化粘胶剂, 使用于 CMOS 封装 Die Attach 工序, 能高温快速固化, 适合高速自动化生产, 耐高温和高强度等特点。

固化前特性

外观	红色
粘度 (cps) 20 RPM, 25°C	4909
固化条件	1min@150°C
储存期 @ -5°C,月	6

注: 固化温度是指到达胶水表面的实际温度

固化后特性

玻璃化温度 (TMA)	102°C
硬度 D	80D
降解温度	372°C
工作温度	-55-180°C

储存条件和应急处理

本产品需冷冻储存。使用前请先移至室温解冻, 10ml包装至少解冻0.5小时, 30ml包装解冻不少于2小时, 使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触, 对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

包装规格

10ml 针筒; 30ml 针筒;

注:

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据以及对于生产过程中因使用不当产生的任何问题不承担责任, 我们建议客户正式使用前及最终决定本产品是否适用其工艺请提前做好各种测试工作和评估。